

表面処理技術のさらなるグローバル展開をめざして

第54期・2014年3月期

決算説明会資料

株式会社 JCU

東証1部 4975

2014年5月14日(水)

<http://www.jcu-i.com/>



- 
- 2014年3月期決算概況
 - トピックス

2014年3月期業績概況

【連結】

(単位: 百万円)

決算期	2013年3月期	2014年3月期			
	実績	期首予想	修正予想	実績	対前期増減率
売上高	14,581	15,800	16,000	16,467	12.9 %
営業利益	1,807	2,100	2,500	2,726	50.8 %
経常利益	1,902	2,100	2,600	2,964	55.8 %
当期純利益	1,080	1,300	1,600	1,763	63.2%
1株当たり 当期純利益	306円43銭	368円56銭	453円61銭	500円07銭	—

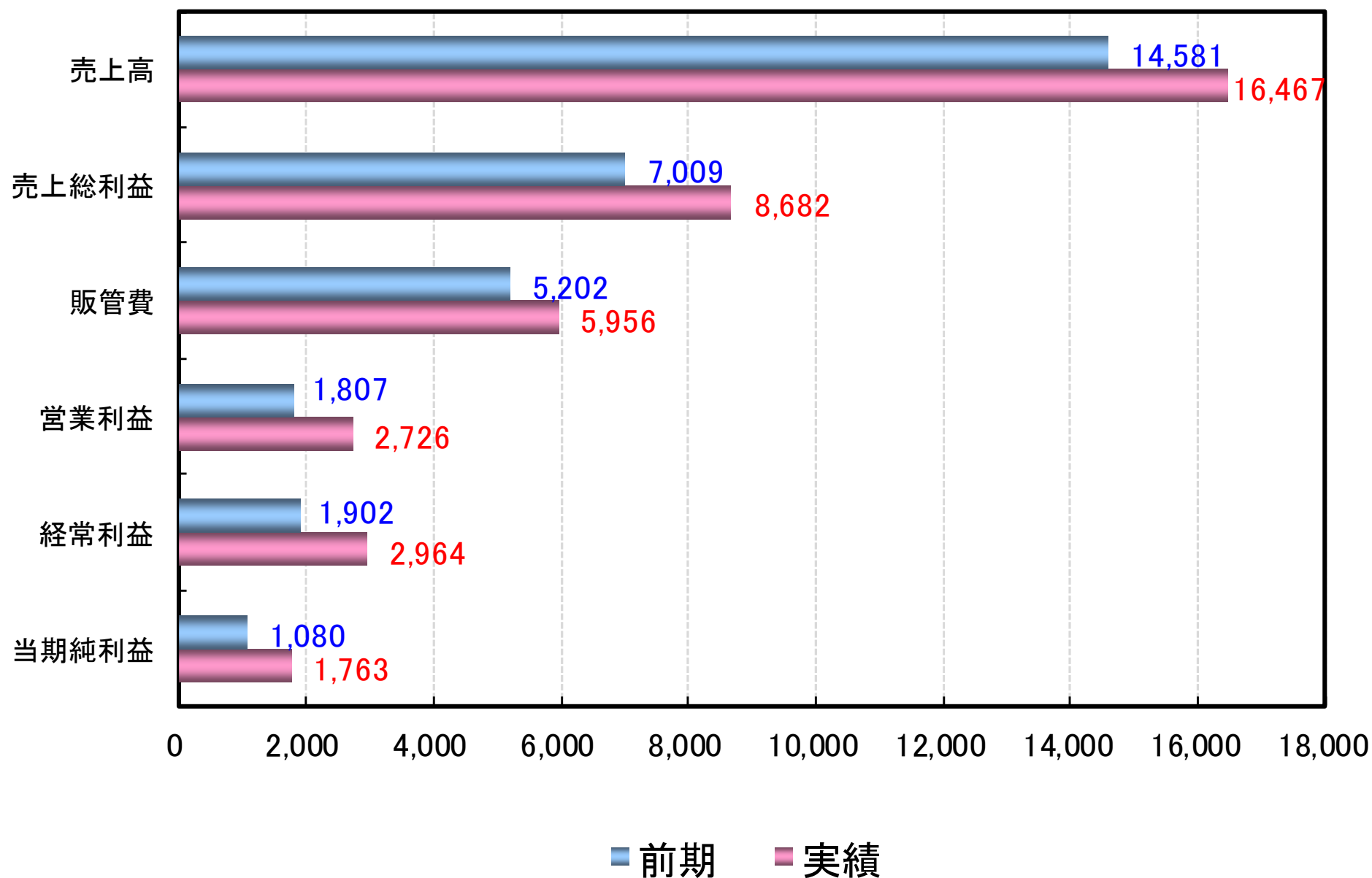
貸借対照表 要約

(百万円)	2013年3月期	2014年3月期
流動資産	10,630	12,049
現金及び預金	4,054	4,993
受取手形及び売掛金	4,152	4,527
たな卸資産	1,154	1,273
固定資産	4,766	5,084
有形固定資産	2,991	3,238
投資その他の資産	1,577	1,708
資産合計	15,396	17,133
流動負債	5,607	5,095
支払手形及び買掛金	2,497	2,145
短期借入金(一年内長期含む)	791	794
固定負債	2,088	2,034
長期借入金	971	861
負債合計	7,696	7,129
純資産合計	7,699	10,004
負債・純資産合計	15,396	17,133

※一部の勘定科目について省略しております。

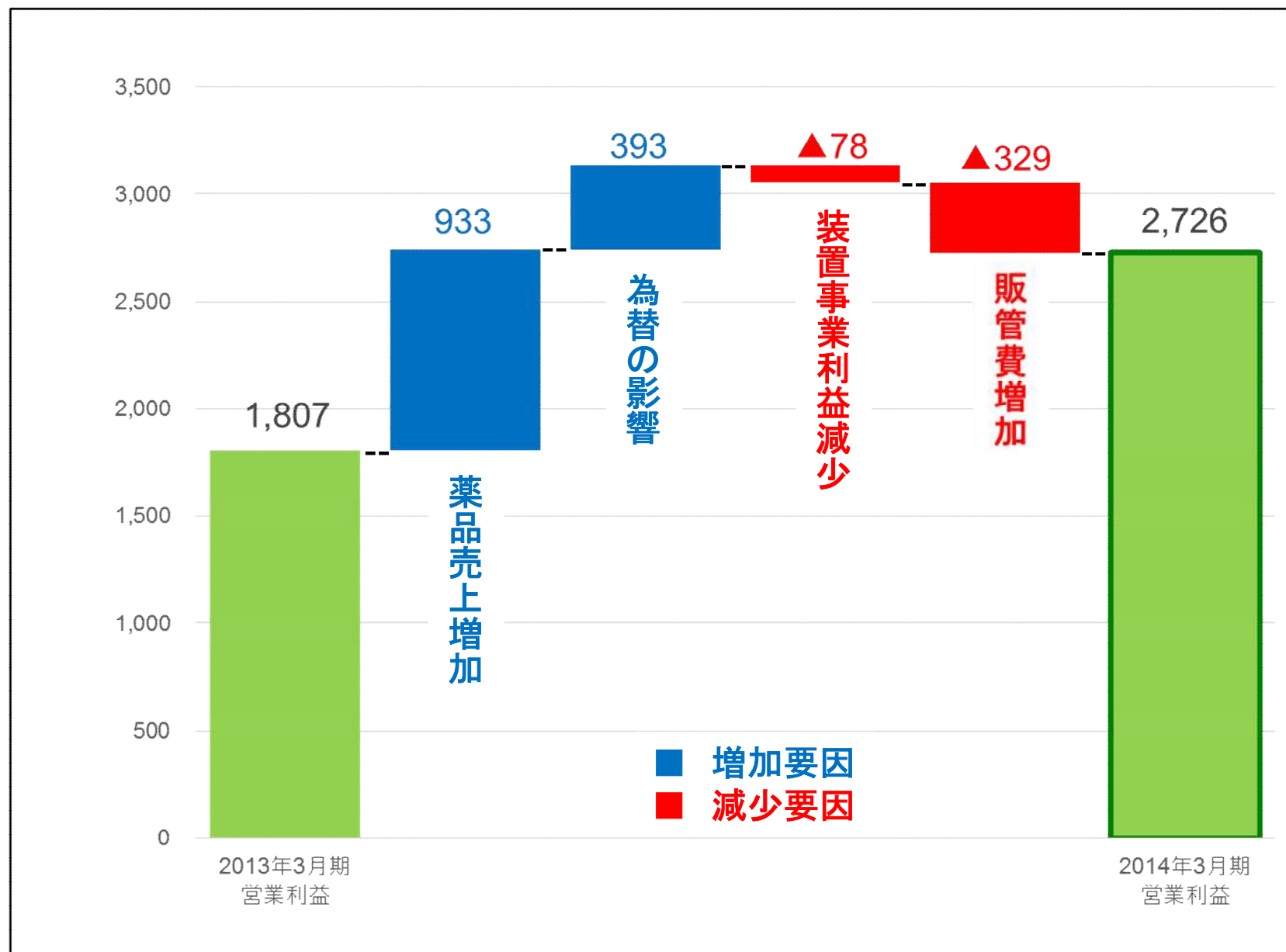
2014年3月期 連結業績 前年対比

(単位:百万円)



2014年3月期 連結営業利益 増減内容

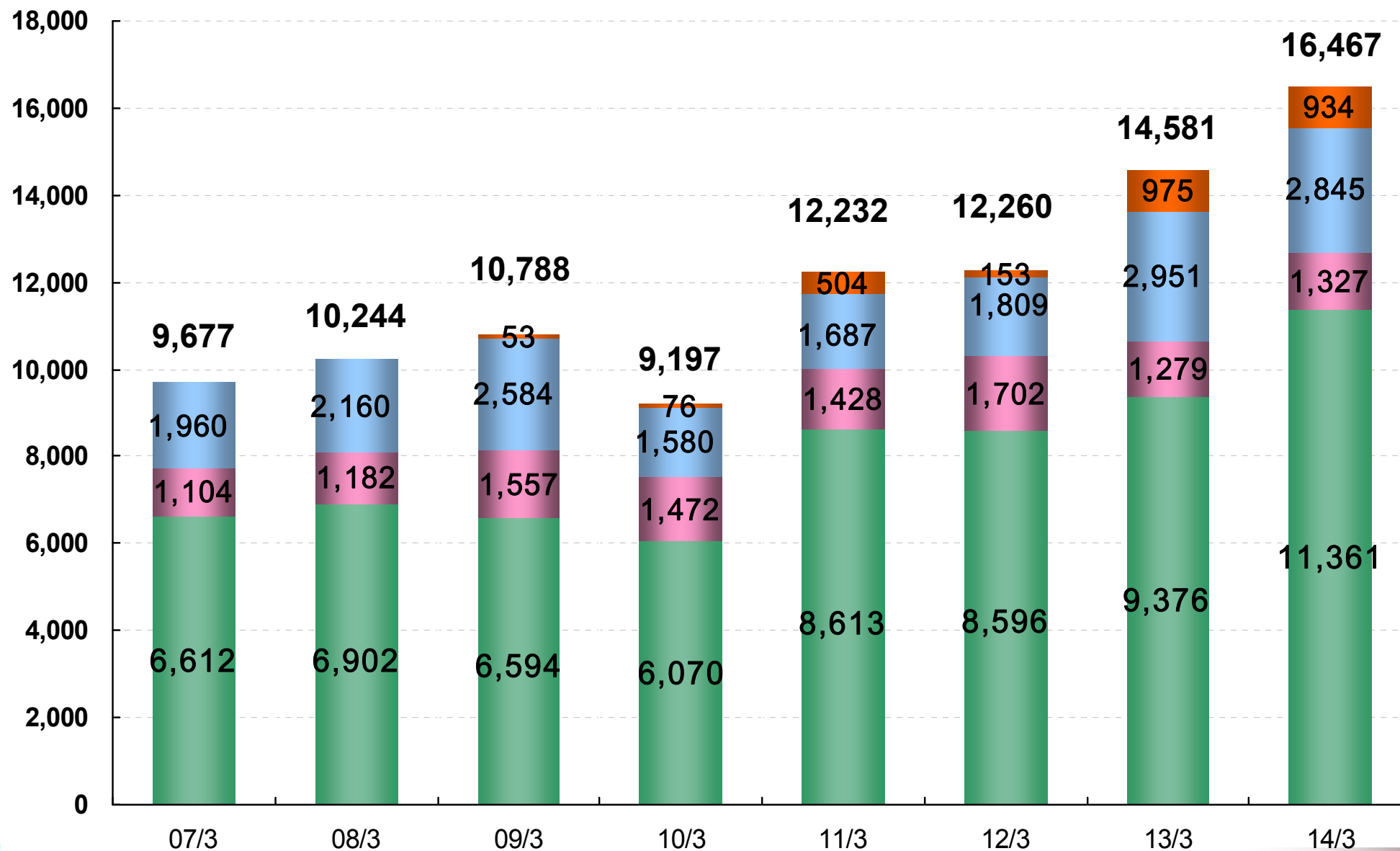
(単位:百万円)



(前期比)
+ 919

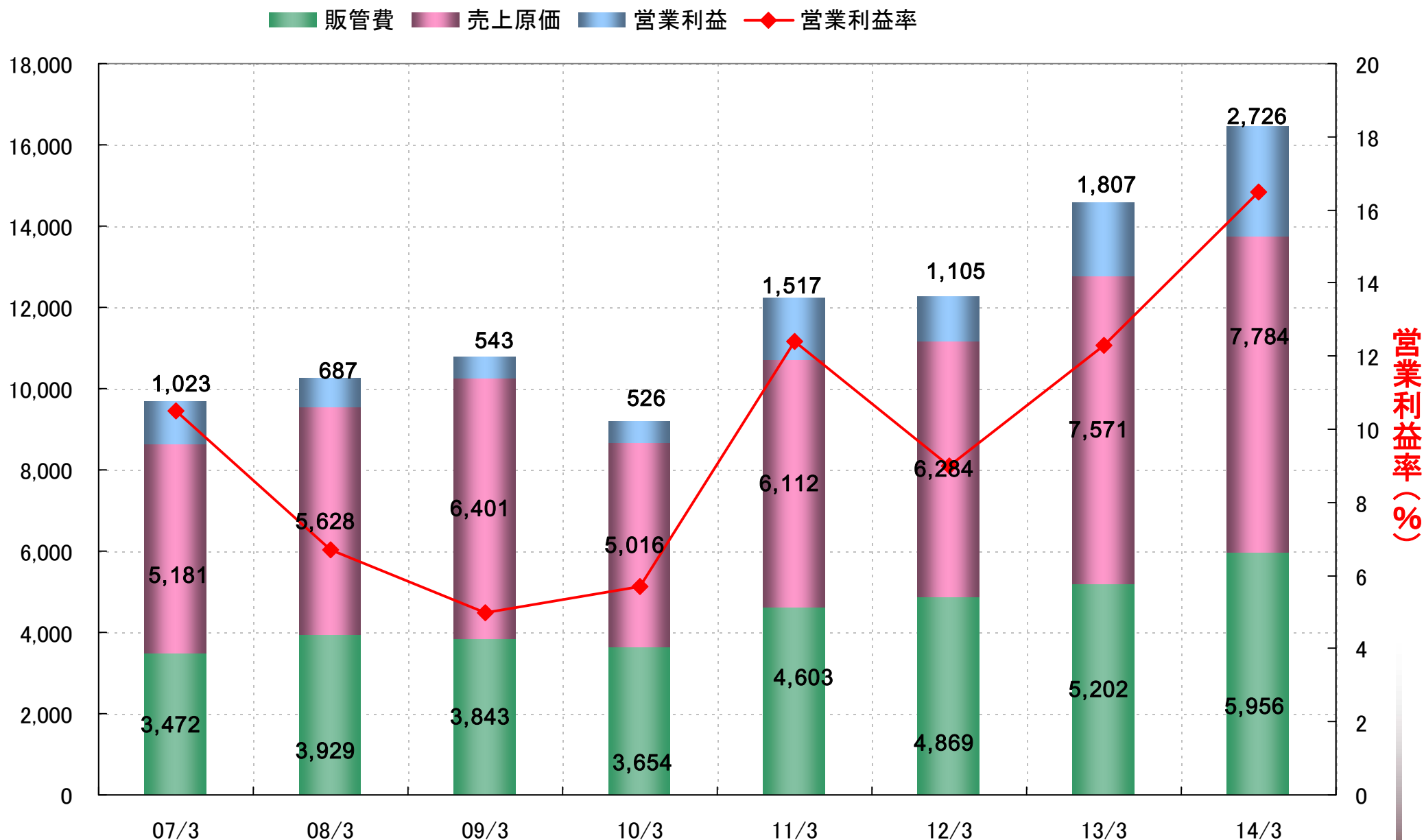
年度別製品構成別売上高推移

■ 薬品 ■ 関連資材 ■ 装置 ■ 新規事業 (単位: 百万円)



年度別販管費・売上原価・営業利益・営業利益率推移

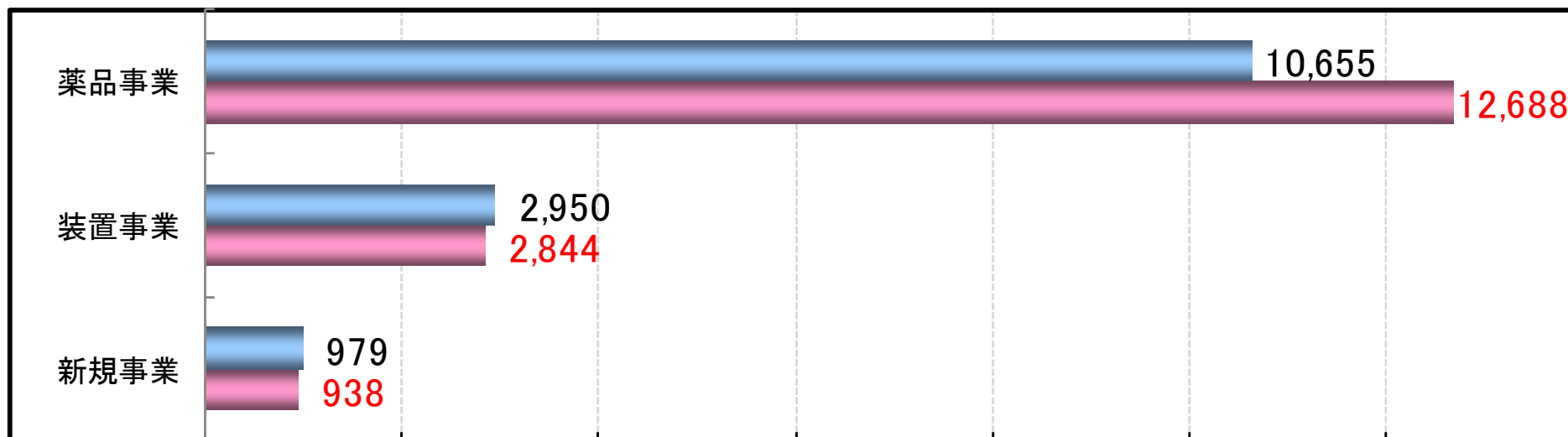
販管費・売上原価・営業利益 (百万円)



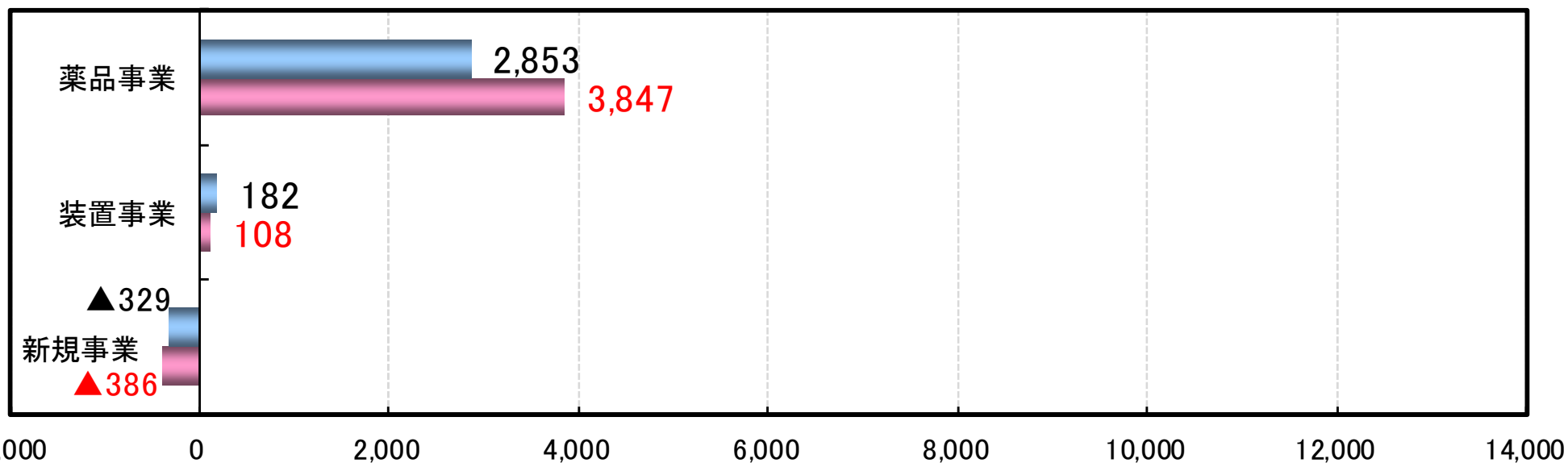
2014年3月期 連結セグメント業績

(単位:百万円)

売上高



セグメント利益



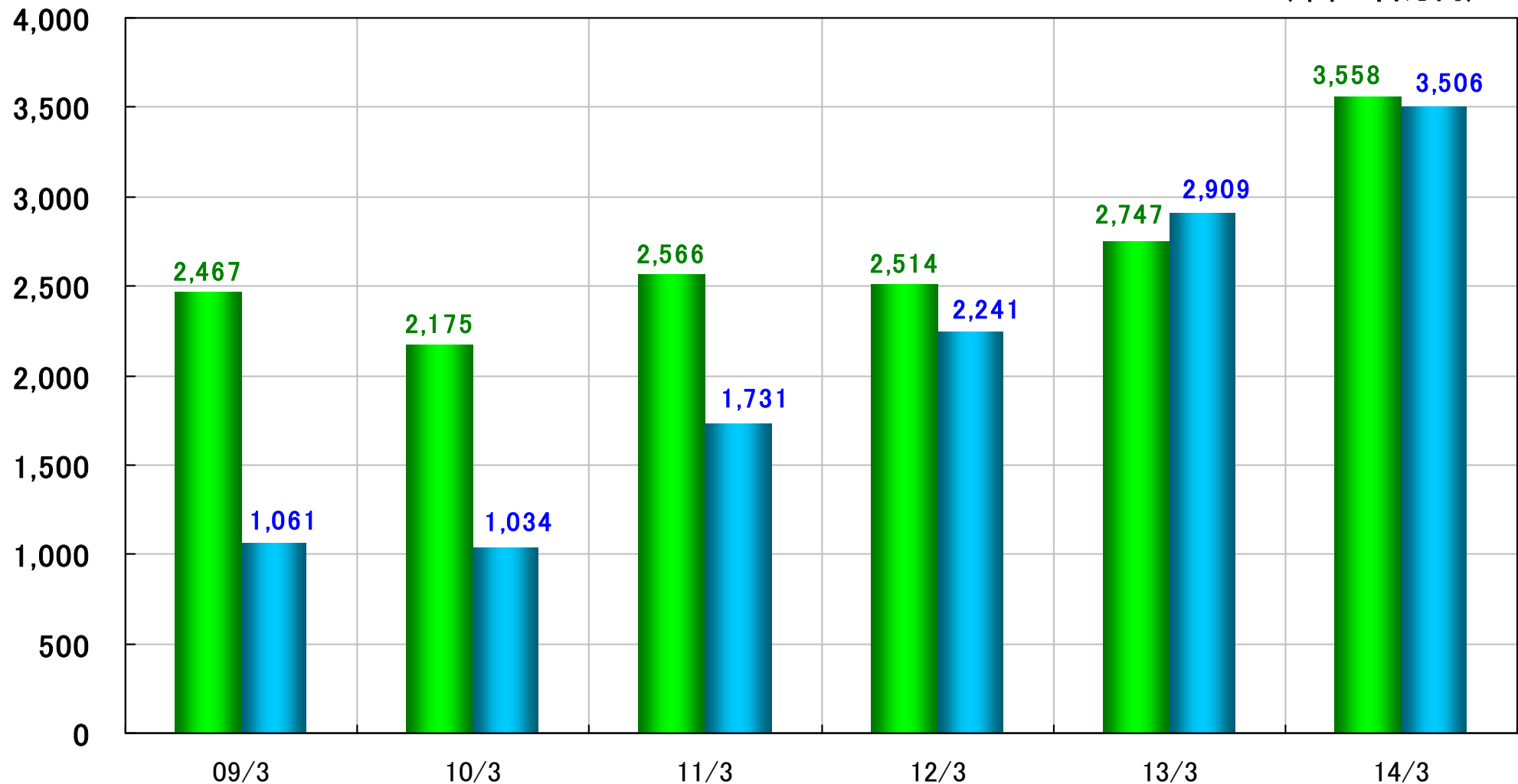
■ 前期 ■ 実績

POP、ビアフィリング用薬品の売上高推移

POP・・・Plating on Plastics (プラスチック上へのめっきで、主に自動車部品向け)

■ POP ■ ビアフィリング

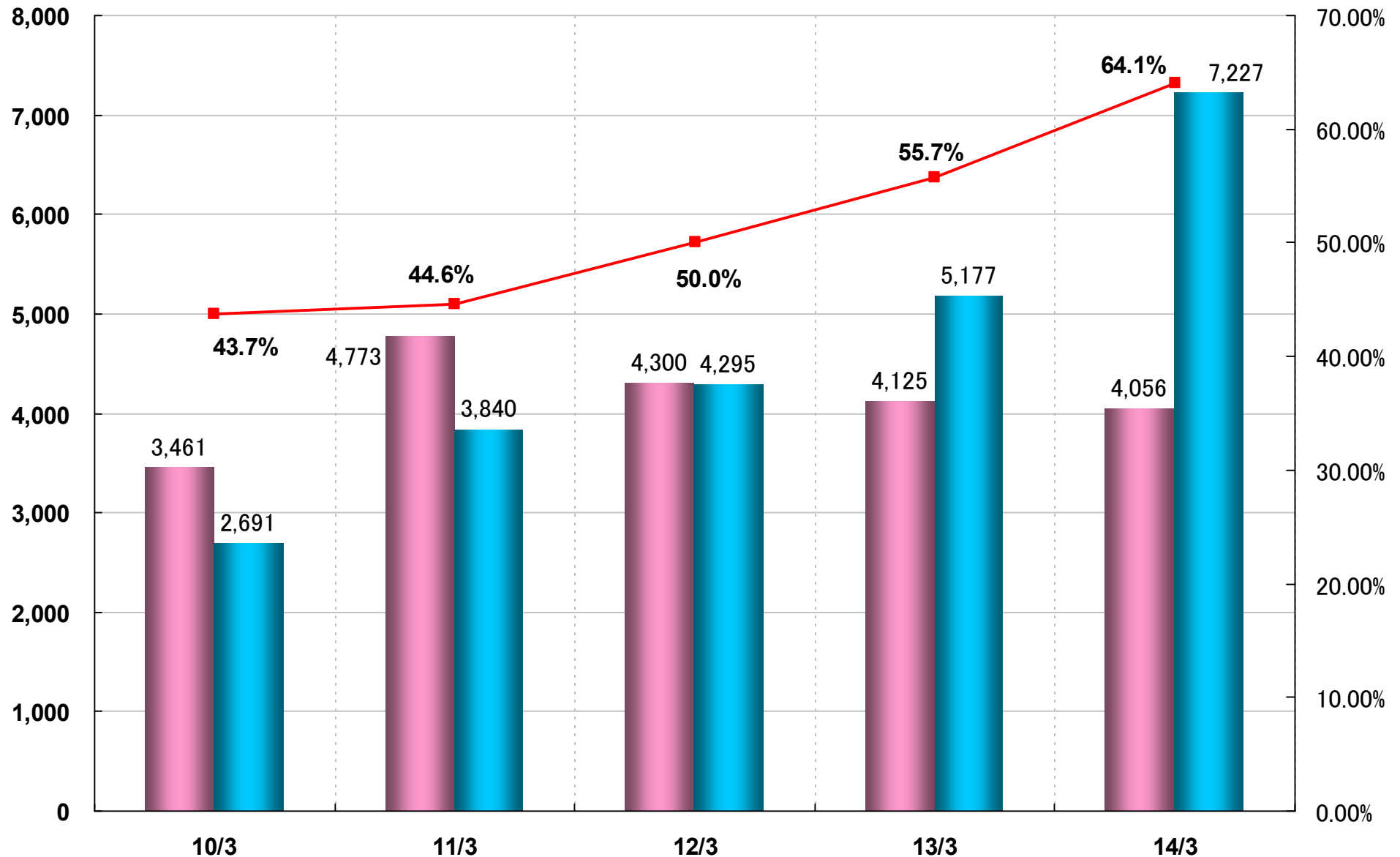
(単位: 百万円)



薬品全体の国内・海外マーケット別売上高推移

(単位: 百万円)

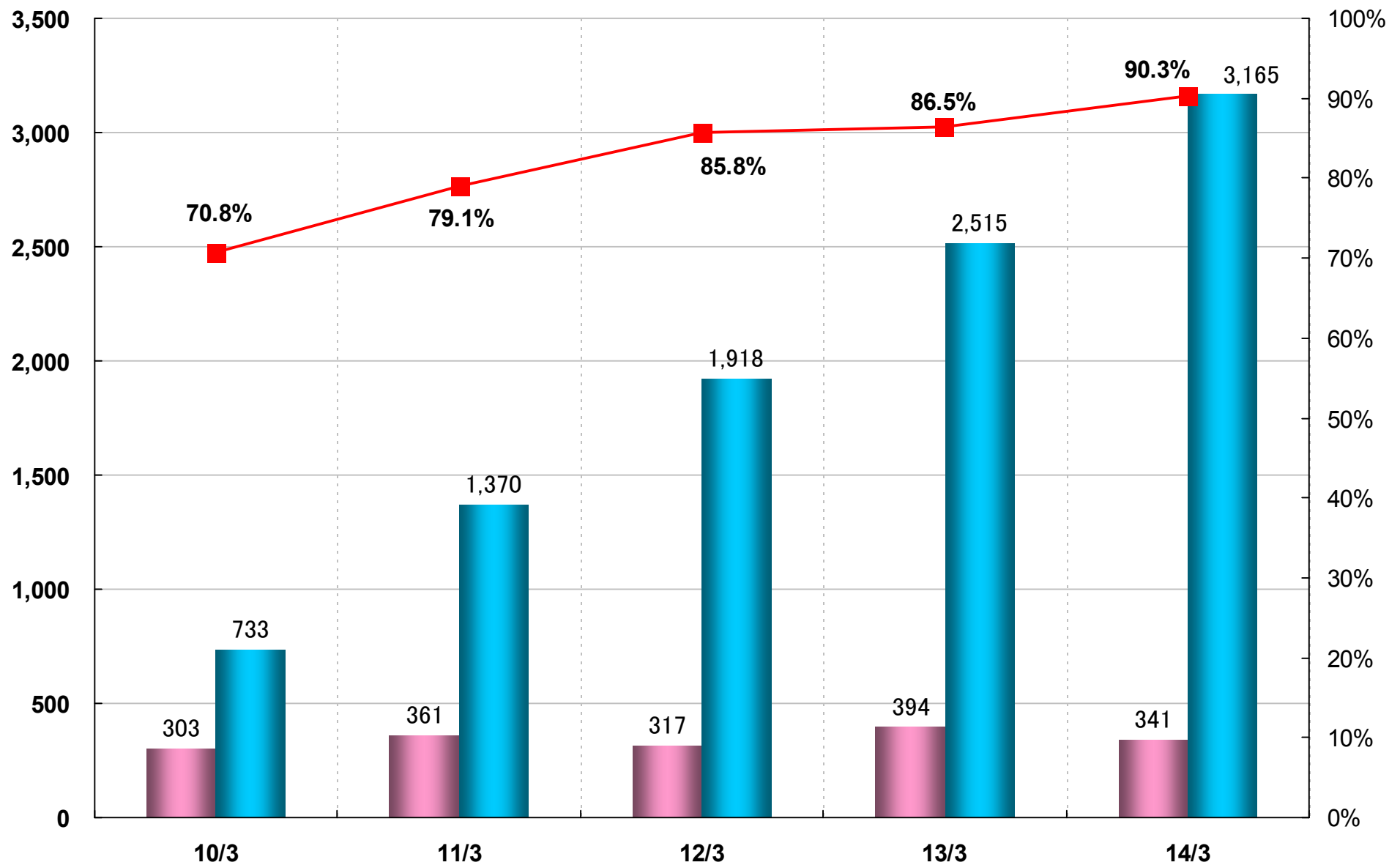
■ 国内 ■ 海外 ■ 海外比率



主力製品ビアフィル用薬品国内・海外マーケット別売上高推移

(単位: 百万円)

国内 海外 海外比率



配当状況

	1株当たり配当金		
	中間	期末	年間
15年3月期 (予定)	65円	65円	130円
14年3月期	55円 (内:記念配当10円)	55円	110円
13年3月期	35円	45円 (内:記念配当10円)	80円
12年3月期	30円	30円	60円

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために適正な自己資本比率を維持しつつ、業績の状況に応じて配当性向等を勘案し、安定した配当を実施することを基本方針としております。内部留保資金の用途につきましては、今後の事業活動並びに経営基盤の強化に有効活用していく方針であります。

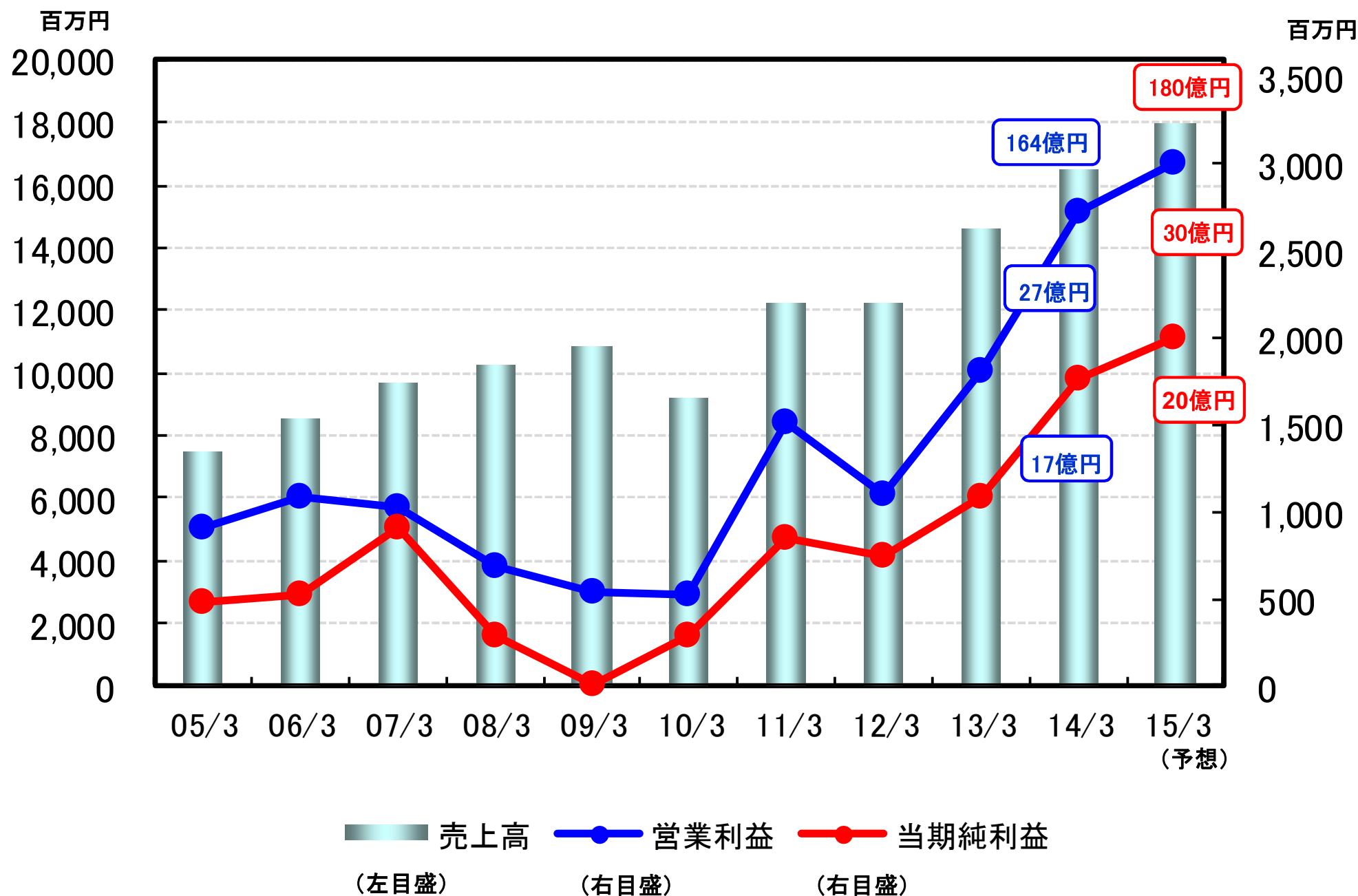
- 
- 2014年3月期決算概況
 - トピックス

業績予想

(単位:百万円)

項 目	2014年3月期	2015年3月期 (予想)	前年同期に 対する増減率
売 上 高	16,467	18,000	9.3 %
営業利益	2,726	3,000	10.0 %
経常利益	2,964	3,000	1.2 %
当期純利益	1,763	2,000	13.4 %
1株当たり 当期純利益	500円07銭	567円03銭	—
配 当	110円 第2四半期末:55円 期末:55円	130円 第2四半期末:65円 期末:65円	20円増配

業績の推移（予想）



ベトナム現地法人: JCU VIETNAM CORPORATION

ベトナム市場

- ◆ 近年、輸出の主であった繊維産業に代わり電子機器産業が台頭
- ◆ 韓国大手メーカーが、スマートフォン第2製造工場建設を発表
- ◆ 自動車部品関連でタイ・プラス・ワンとして注目 (タイの人件費高騰)

当社の対応

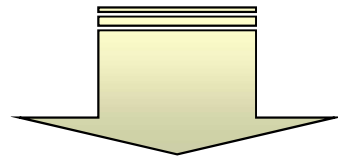
- ◆ 2007年に現地法人を設立
- ◆ 日本人3名を派遣し、日系企業へのサポート体制を拡充
- ◆ 新工場の建屋が5月30日完成、7月から生産開始予定



ベトナム新工場(完成予定図)

今後の方策

- ◆ 今後も日系企業の進出と規模拡大が見込まれる
⇒ 進出企業を現地でフルサポート（取引先との厚い信頼関係）
- ◆ 技術サービス向上を目指した、現地スタッフの教育
⇒ 取引先に日本と同じ感覚でサポートを受けていただく環境
- ◆ 新工場の生産能力は、最大で現在8倍まで拡張可能
⇒ 売上拡大に伴いコスト低減で利益向上



他社に先駆け、成長し続けるベトナム市場での定着を図る

背景

- ◆ パソコン、スマートフォンの高性能化 → 内装部品(基板)の高密度化
- ◆ 半導体とプリント基板の接続 → 微細化が究極的な局面
- ◆ 現在の接続工法では、更なる高密度化に対応できない。

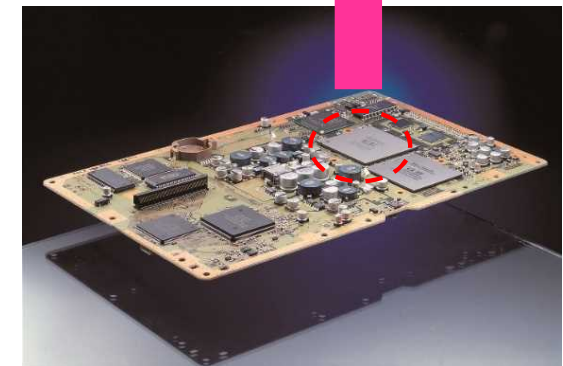
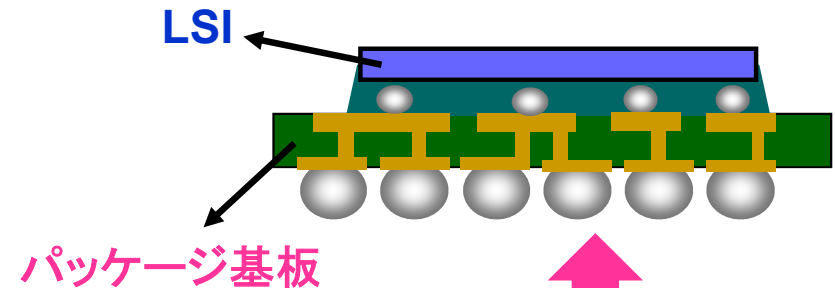
ナノ(nm)サイズの半導体LSI

ミリ(mm)サイズのマザー基板

この2つを繋ぐのが

ミクロン(μm)サイズのパッケージ基板

微細化に対応した新しい工法が必要

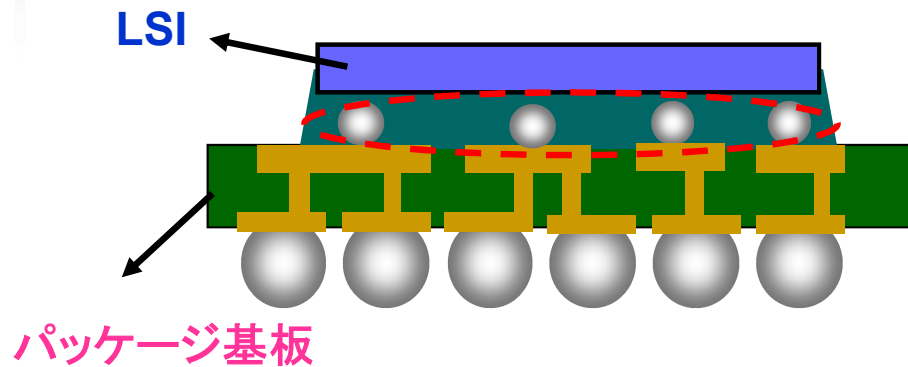


実装基板(マザー)

技術トピック: 銅ピラー接続工法

現工法

半田マイクロボール接続

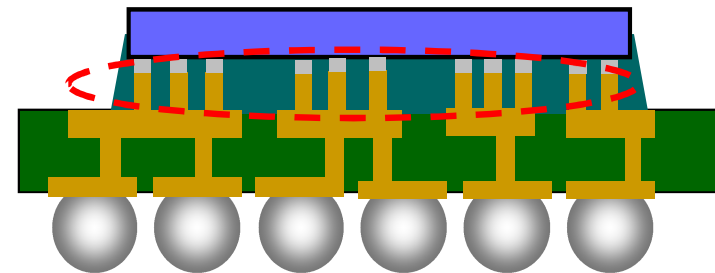


半導体LSIとパッケージ基板を半田ボールを溶解し接続。

配線数の増加(高密度化)に伴い溶解接続時に電気的な短絡(ショート)のリスク大

新工法

銅ピラー接続



半導体LSIとパッケージ基板を銅ピラー(銅の柱)で接続。

電気的な短絡を大幅に低減でき、配線数の増加(高密度化)に対応可能。

技術トピック:銅ピラー接続工法

課題

この新工法は、銅ピラーだけではなく、前工程から後工程まで 数多くの工程が必要

当社の強み

前後工程の開発まで手掛けており、今日までにその全工程をラインナップ
⇒ 他社に先駆け、環境変化(工法変更)に対応可能

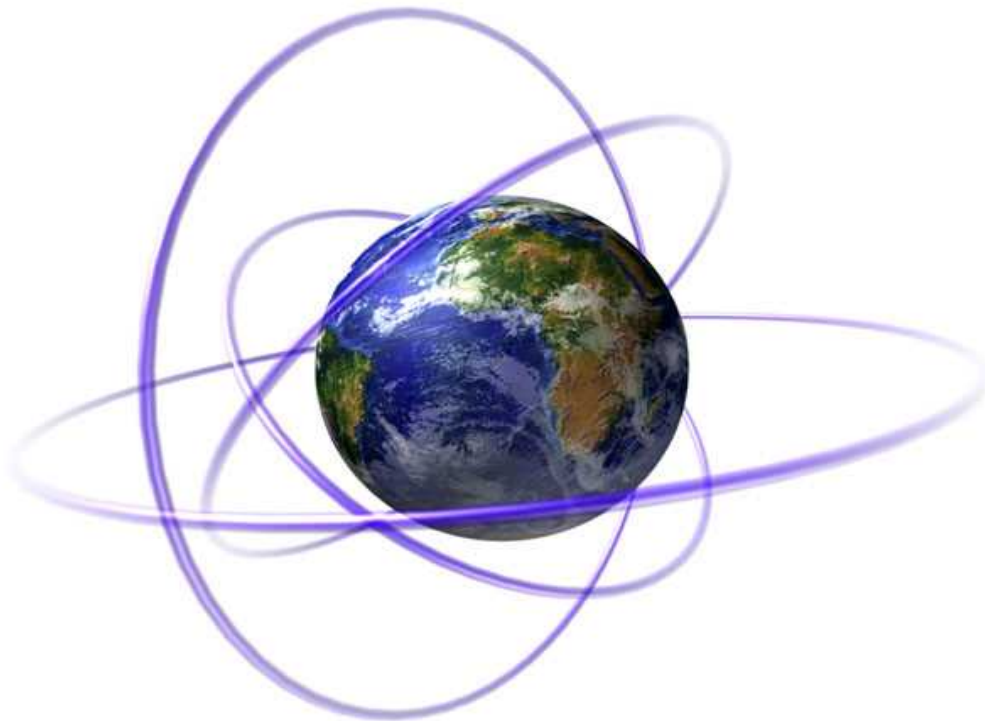
市場

高性能スマートフォン、ウェアラブルデバイス

将来性

人工知能を要する高性能ナビゲーション
⇒ 先進運転支援システム(自動運転技術)へ適用を期待

この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異なる場合があります、この資料はその実現を確約したり、保証するものではありません。



当社ホームページ:

<http://www.jcu-i.com/>

お問い合わせ先:

TEL: 03-6895-7001

FAX: 03-6895-7021

Mail: ir@jcu-i.com